

2024-2030年中国人工智能 芯片行业前景展望与投资战略研究报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2024-2030年中国人工智能芯片行业前景展望与投资战略研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202312/426817.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2024-2030年中国人工智能芯片行业前景展望与投资战略研究报告》报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，是企业布局市场服务行业的重要决策参考依据。 报告目录：第一章 人工智能芯片基本概述 1.1 人工智能芯片的相关介绍 1.1.1 芯片的定义及分类 1.1.2 人工智能芯片的内涵 1.1.3 人工智能芯片的要素 1.2 人工智能芯片与人工智能的关系 1.2.1 人工智能的内涵 1.2.2 人工智能对芯片的要求提高 1.2.3 人工智能芯片成为战略高点 第二章 人工智能芯片行业发展机遇分析 2.1 产业机遇 2.1.1 人工智能步入黄金时期 2.1.2 人工智能投资规模上升 2.1.3 人工智能应用前景广阔 2.2 技术机遇 2.2.1 芯片计算能力大幅上升 2.2.2 云计算逐步降低计算成本 2.2.1 深度学习对算法要求提高 2.2.2 移动终端应用提出新要求 2.3 政策机遇 2.3.1 集成电路产业发展纲要发布 2.3.2 人工智能行动实施方案发布 2.3.3 人工智能发展规划强调AI芯片 第三章 人工智能芯片背景产业——芯片行业 3.1 芯片专利申请状况 3.1.1 专利的分类及收购 3.1.2 各国专利申请排名 3.1.3 企业专利申请排名 3.1.4 我国专利申请概况 3.2 芯片市场运行分析 3.2.1 国际市场依赖性强 3.2.2 芯片市场发展提速 3.2.3 芯片产业运行现状 3.2.4 企业运营动态分析 3.2.5 芯片产业发展态势 3.2.6 存储芯片发展机遇 3.3 芯片材料行业发展分析 3.3.1 半导体材料市场回顾 3.3.2 半导体材料市场现状 3.3.3 半导体材料研发动态 3.3.4 半导体产业发展趋势 3.4 芯片材料应用市场分析 3.4.1 芯片应用市场综况 3.4.2 家电芯片行业分析 3.4.3 手机芯片市场分析 3.4.4 LED芯片市场状况 3.4.5 车用芯片市场分析 3.5 集成电路贸易分析 3.5.1 中国集成电路进出口总量数据分析 3.5.2 主要贸易国集成电路进出口情况分析 3.5.3 主要省市集成电路进出口情况分析 3.6 国内芯片产业发展的问题及对策 3.6.1 国产芯片产业的差距 3.6.2 国产芯片落后的原因 3.6.3 国产芯片发展的建议 3.6.4 产业持续发展的对策 第四章 人工智能芯片行业发展分析 4.1 人工智能芯片行业发展综况 4.1.1 人工智能芯片发展阶段 4.1.2 人工智能芯片市场规模 4.1.3 人工智能芯片产业化状况 4.2 企业加快人工智能芯片行业布局 4.2.1 互联网公司布局AI芯片市场 4.2.2 百度发布Duer OS智慧芯片 4.2.3 高通旗舰芯片正式发布 4.2.4 三星注资AI芯片制造公司 4.3 科技巨头打造“平台+芯片”模式 4.3.1 阿里云 4.3.2 百度开放云 4.4 中美人工智能芯片行业实力对比 4.4.1 技术实力对比 4.4.2 企业实力对比 4.4.3 人才实力对比 4.5 人工智能芯片行业发展问题及对策 4.5.1 发展问题 4.5.2 发展对策 第五章 人工智能芯片细分领域分析 5.1 人工智能芯片的主要类型及对比 5.1.1 人工智能芯片主要类型 5.1.2 人工智能芯片对比分析 5.2 GPU芯片分析

5.2.1 GPU芯片简介 5.2.2 GPU芯片特点 5.2.3 国外企业布局GPU 5.2.4 国内GPU产业分析 5.3 FPGA芯片分析 5.3.1 GPU芯片简介 5.3.2 GPU芯片特点 5.3.3 FPGA市场规模 5.3.4 国内FPGA行业分析 5.4 ASIC芯片分析 5.4.1 ASIC芯片简介 5.4.2 ASIC芯片特点 5.4.3 ASI应用领域 5.4.4 国际企业布局ASIC 5.4.5 国内ASIC行业分析 5.5 类脑芯片(人脑芯片)分析 5.5.1 类脑芯片简介 5.5.2 类脑芯片最新成果 5.5.3 国外类脑芯片研发 5.5.4 国内类脑芯片研发 5.5.5 类脑芯片典型代表 5.5.6 类脑芯片前景可期 第六章 人工智能芯片重点应用领域 6.1 人工智能芯片应用状况分析 6.1.1 AI芯片的应用场景 6.1.2 AI芯片的应用潜力 6.1.3 AI芯片的应用空间 6.2 智能手机行业 6.2.1 智能手机出货规模 6.2.2 中国智能手机市场动态 6.2.3 手机企业加快AI芯片布局 6.2.4 手机AI应用芯片研发加快 6.2.5 AI芯片或应用于苹果手机 6.3 智能音箱行业 6.3.1 智能音箱市场概况 6.3.2 智能音箱销售规模 6.3.3 企业加快行业布局 6.3.4 芯片厂商积极布局 6.3.5 典型AI芯片应用案例 6.4 机器人行业 6.4.1 市场需求及机会领域分析 6.4.2 智能机器人市场规模状况 6.4.3 机器人领域投资状况分析 6.4.4 FPGA在机器人上的应用 6.4.5 企业布局机器人驱动芯片 6.5 智能汽车行业 6.5.1 国际企业加快车用AI芯片研发 6.5.2 国内智能汽车行业发展状况 6.5.3 国内无人驾驶实现规范化发展 6.5.4 AI芯片将应用于智能汽车领域 6.6 其他领域 6.6.1 无人机高性能芯片 6.6.2 智能家电芯片 6.6.3 智能穿戴芯片 6.6.1 智能眼镜芯片 6.6.2 人脸识别芯片 第七章 国际人工智能芯片典型企业分析 7.1 Nvidia(英伟达) 7.1.1 企业发展概况 7.1.2 财务运营状况 7.1.3 市场份额分析 7.1.4 AI芯片产业地位 7.1.5 AI芯片产业布局 7.2 Intel(英特尔) 7.2.1 企业发展概况 7.2.2 企业财务状况 7.2.3 AI芯片产品介绍 7.2.4 AI芯片产业布局 7.3 Qualcomm(高通) 7.3.1 企业发展概况 7.3.2 财务运营状况 7.3.3 AI芯片产业布局 7.3.4 AI芯片研发动态 7.4 IBM 7.4.1 企业发展概况 7.4.2 企业财务状况 7.4.3 AI芯片产品研发 7.4.4 AI芯片研发动态 7.5 Google(谷歌) 7.5.1 企业发展概况 7.5.2 企业财务状况 7.5.3 AI芯片产业布局 7.5.4 云端AI芯片发布 7.6 Microsoft(微软) 7.6.1 企业发展概况 7.6.2 企业财务状况 7.6.3 AI芯片产业布局 7.6.4 AI芯片研发动态 7.7 其他企业分析 7.7.1 苹果公司 7.7.2 Facebook 7.7.3 CEVA 7.7.4 ARM 第八章 国内人工智能芯片重点企业分析 8.1 地平线机器人公司 8.1.1 企业发展概况 8.1.2 企业融资状况 8.1.3 发展实力分析 8.1.4 AI芯片产业布局 8.1.5 AI芯片研发动态 8.2 中科寒武纪 8.2.1 企业发展概况 8.2.2 企业合作动态 8.2.3 企业融资动态 8.2.4 AI芯片产品研发 8.3 中兴 8.3.1 企业发展概况 8.3.2 运营状况分析 8.3.3 芯片发展实力 8.3.4 AI芯片发展布局 8.4 华为 8.4.1 企业发展概况 8.4.2 技术研发实力 8.4.3 AI芯片产品发布 8.4.4 AI芯片产业布局 8.5 其他企业发展动态 8.5.1 科大讯飞 8.5.2 中星微电子 8.5.3 BAT企业 第九章 人工智能芯片行业投资壁垒及发展前景分析 9.1 人工智能芯片行业进入壁垒分析 9.1.1

专利技术壁垒 9.1.2 市场竞争壁垒 9.1.3 投资周期漫长 9.2 人工智能芯片行业发展前景
9.2.1 人工智能软件市场展望 9.2.2 国内AI芯片将加快发展 9.2.3 AI芯片细分市场发展前景
9.3 人工智能芯片的发展路线及方向 9.3.1 人工智能芯片发展态势 9.3.2 人工智能芯片发展路径 9.3.3 人工智能芯片技术趋势 9.4 人工智能芯片定制化趋势分析 9.4.1 AI芯片定制化发展背景 9.4.2 半定制AI芯片布局加快 9.4.3 全定制AI芯片典型代表

略••••;完整报告请咨询客服 图表目录 图表 芯片与集成电路 图表 人工智能定义 图表 人工智能三个阶段 图表 人工智能产业结构 图表 人工智能产业结构具体说明 图表 16位计算带来两倍的效率提升 图表 人工智能历史发展阶段 图表 人工智能公司融资额 图表 国内人工智能行业投资情况 图表 Intel芯片性能相比第一款微处理器大幅提升 图表 Intel芯片集成度时间轴 图表 云计算形成了人工智能有力的廉价计算基础 图表 人工智能发展战略目标 图表 专利提高效率的过程 图表 专利收购业务的一般交易模型 图表 半导体材料市场销售额 图表 我国半导体市场需求额占世界半导体的份额 图表 各地区半导体材料市场占比变化 图表 各地区半导体材料市场规模 图表 各地区半导体材料销售额变化 图表 IC材料市场规模及增长率 图表 晶圆制造材料和封装材料占比变化 图表 我国半导体材料行业市场规模及增速 图表 各类家电的混合信号中央处理芯片 图表 热门手机芯片品牌分布

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202312/426817.html>